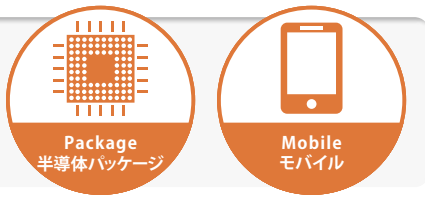
Panasonic

For secondary mounting reinforcement drop impact resistance liquid encapsulant
二次実装補強用 耐落下衝撃性液状封止材

LEXCM AF
CV5313 CV5314

Applications 用途

LSI package and SSD for mobile devices such as notebook PC, digital camera, mobile phones, smartphone and tablet PC.
LSI パッケージ、SSD（ノート PC、デジカメ、携帯電話、スマートフォン、タブレット PC 用）



Protection of “brain” of mobile terminal from drop impact.
Underfill/Sidefill reinforcement material when BGA/CSP is mounted.
モバイル端末の「ブレイン」を落下衝撃から守ります。
BGA、CSP 実装時のアンダーフィル・サイドフィル補強材料

Drop impact resistance 耐落下衝撃

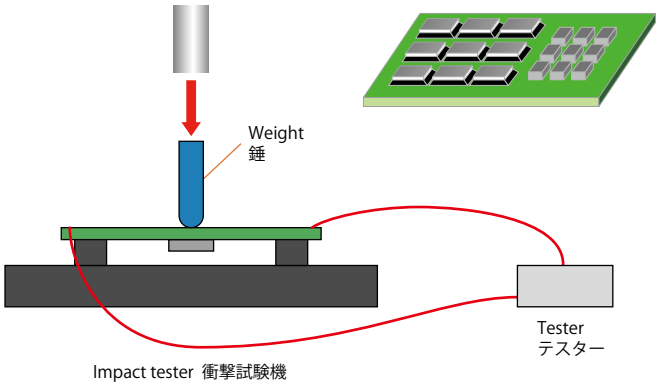
Underfill reinforcement アンダーフィル補強

Sidefill reinforcement サイドフィル補強

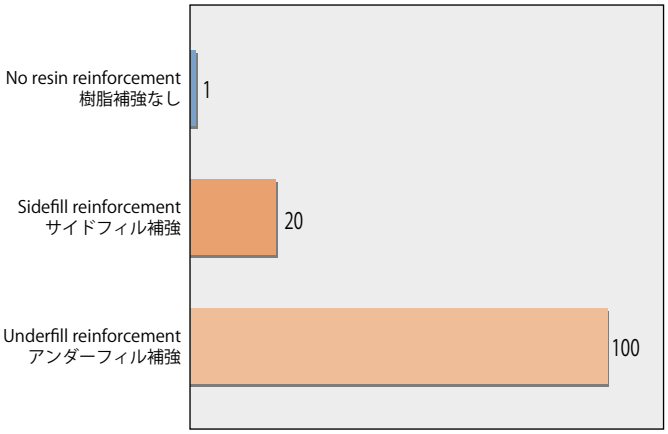
Comparison of impact test evaluations 衝撃試験評価比較

● Test conditions
試験条件

Strain amount 歪み量	3000 μST (Weight 50g 30cm drop)
BGA	W14mm×D14mm×H1.2mm
Board 基板	W35mm×D70mm×H0.6mm



● Number of times of dropping before cracking occurs
クラック発生までの落下回数



General properties 一般特性

Item	Unit	CV5313 Underfill	CV5314 Sidefill
Viscosity (25℃)	Pa·s	2	130
Thixotropic index	—	1.2	3.5
Gel time (150℃)	sec	50	70
Curing condition	—	120℃ 5min	120℃ 5min
Tg	℃	105	80
C.T.E. (α1)	ppm/℃	70	35
Flexural modulus	GPa	3	7

The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/ww/electronic-materials
panasonic electronic materials
Panasonic Corporation Electronic Materials Business Division
パナソニック株式会社　電子材料事業部

Please see our website for Notes before you use.　商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。
© Panasonic Corporation 2021　202110